

테크윙(089030)

내 스토리는 이제 시작

반도체 테스트 핸들러 전문업체

테크윙은 반도체 핸들러 검사장비 제조업체다. 핸들러 장비는 후공정에 쓰이며 테스트를 해야하는 반도체 칩을 비전 기술을 활용해 정렬하고, 검사장비로 이동시켜 주는 자동화 장비다. 따라서 온도제어, 검사속도, Para(한 번에 검사 할 수 있는 칩의 개수) 등이 테크윙의 기술력이다. 2023년 기준 테크윙은 글로벌 메모리 핸들러 시장에서 점유율 70%로 1위를 차지하고 있으며 주요 고객사로 SK하이닉스, 마이크론 등 대형 메모리사가 있다. 테크윙은 오랜 기술력을 바탕으로 꾸준히 신제품을 개발해왔다. 비메모리 반도체 테스트 핸들러를 개발해 현재 글로벌 비메모리 핸들러 시장에서 5% 점유율을 차지하고 있다. 테크윙의 부품 매출도 전체 매출에서 45%로 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 COK (Change over kit) 비중이 부품 매출에서 70%를 차지한다. COK는 쟁반 형태를 지닌 금속 소모성 부품이며 검사 대상에 따라 교체 수요도 발생한다. 향후 공정 전환(Tech migration)에 따른 교체 수요 증가도 실적에 긍정적으로 작용할 것이다.

투자포인트 1: HBM 테스트 장비 Cube Prober

테크윙은 HBM 테스트인 Cube Prober 장비를 개발했으며 고객사 쉘 테스트 진행 중이다. 기존 HBM 테스트는 절단 후 샘플테스트만 진행해 납품 후 불량률이 있을 경우 교체해주는 형식으로 진행했다. 하지만 HBM의 단수가 높아질수록 수율이 낮아지면서 교체 물량 증가에 따른 비용 상승이 예상되는 상황이다. 이에 전수 검사에 대한 필요성이 높아졌고 Cube Prober는 이러한 니즈를 충족시켜줄 수 있는 장비다. Cube Prober를 활용 시 절단 후 모든 칩에 대해 테스트를 진행하기 때문에 절단으로 인한 불량까지 모두 포착이 가능해진다. Cube Prober 장비에는 핸들러 장비 기술력이 많이 적용된다. 절단한 칩들을 재배열 후 프로브스테이션으로 이동해 테스트를 진행하는데, 재배열할 때 비전 얼라인(Vision Align), 컨택, 온도 등 기술이 모두 집약 되어야 한다. 현재 나머지 메모리 2개사와의 쉘 테스트도 준비중에 있다. 한 개사와는 2025년 1월 중순으로 확정됐고, 나머지 한 개사는 2025년 4월로 예상된다.

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (x)	EV/EBITDA (x)	PBR (x)	ROE (%)	DY (%)
2019A	187	24	11	292	(46.5)	32	24.1	11.8	1.5	6.4	1.7
2020A	228	38	32	856	193.2	47	14.0	11.9	2.2	17.0	1.0
2021A	256	36	18	242	(71.8)	47	47.4	13.2	1.9	8.6	1.0
2022A	267	58	33	886	266.9	69	6.4	5.5	0.9	14.5	2.3
2023A	134	3	(9)	(260)	NM	13	NM	46.7	1.9	(4.2)	1.1

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

미제시

KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
N/A	N/A	N/A	N/A

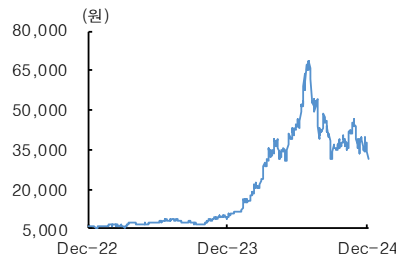
Stock Data

KOSPI(12/12)	2,482
주가(12/12)	32,650
시가총액(십억원)	1,220
발행주식수(백만)	37
52주 최고/최저가(원)	68,700/8,400
일평균거래대금(6개월, 백만원)	54,185
유동주식비율/외국인지분율(%)	82.2/14.6
주요주주(%)	나윤성 외 3인 13.5

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	15.3	28.8	392.3
KOSDAQ 대비(%)	19.7	42.4	393.3

주가추이



자료: FnGuide

조수현

chosuhen@koreainvestment.com

투자포인트 2: 다이 레벨 테스트 장비 DLP

테크윙은 Cube Prober 기술을 바탕으로 현재 베어 다이(Bare Die) 레벨 테스트 장비인 DLP 장비를 개발하고 있다. DLP 장비는 비메모리 테스트 장비로 패키징 이전 칩 상태에서 테스트를 진행하는 장비다. 경쟁사 이슈로 장비의 정확한 컨셉을 확인하기 어렵지만, 해당 장비의 경우 테스트 대상의 칩 크기가 비교적 크기 때문에 기술적 측면에서 Cube Prober 대비 낮은 것으로 파악된다. 핸들링 기술에 있어 정렬 및 비전 기술이 중요한데 칩의 크기가 클수록 정렬이 비교적 쉬워지기 때문이다. 따라서 개발 시기가 크게 지연될 가능성은 낮을 것으로 판단한다.

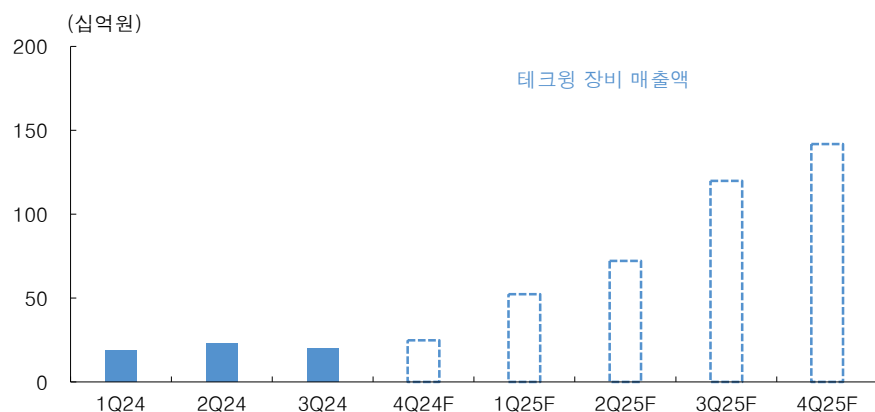
DLP 장비는 연내 개발 완료를 목표로 현재 주요 글로벌 비메모리 고객사인 A사, N사, I사 등 호응이 상당히 좋은 상황이다. 고객사 수요가 많은 것으로 파악되는 만큼 빠르면 2025년 하반기에는 매출에 기여할 전망이다. 현재 당사 추정치에는 DLP 장비는 포함하지 않았기에 2025년 1분기 장비 컨셉 확인 시 더 큰 성장을 기대할 수 있을 것이다.

[그림 1] 테크윙 Cube Prober 제품



자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 2] 테크윙 장비 매출액 추이 및 전망



자료: 테크윙, 한국투자증권

실적 전망: 2024년보다 2025년에 주목

2024년 연간 매출액은 1,919억원(+44% YoY), 영업이익 274억원(+766% YoY)을 기록할 전망이다. 메모리 업황 회복 및 공정 전환에 따른 부품 교체 수요 증가가 실적 성장을 이끌 것이다. 2024년보다 2025년에 주목해야 한다. 신규 장비인 Cube Prober향 매출이 2025년 1분기부터 본격적으로 인식될 것이기 때문이다. 현재 메모리 3사 중 1개사와 쉘 테스트를 진행하고 있으며 나머지 2개사도 연내 쉘 돌입 예정이다. 메모리 3사 모두 쉘 통과 시 2025년 장비 수요는 135대 (회사가 제시한 가이던스 120~150대 중간 값) 수준으로 추정하며 현재 Capa로 충분히 대응이 가능한 수준이다.

Cube Prober 장비를 135대 가정 시 2025년 연간 매출액은 5,244억원(+173% YoY), 영업이익 1,549억원(+466% YoY)을 달성할 전망이다. 특히 OPM의 경우 29.5%로 2024년대비 15.2%p 상승할 것이다. OPM이 개선되는 이유는 Cube Prober의 수익성이 기존 핸들러 대비 높기 때문이다. 향후 메모리 3사 수요 증가 및 DLP 장비까지 매출에 기여할 경우 실적 추정치는 추가 상승이 가능할 것이다.

〈표 1〉 테크윙 실적추정 테이블

(단위: 십억원, %)

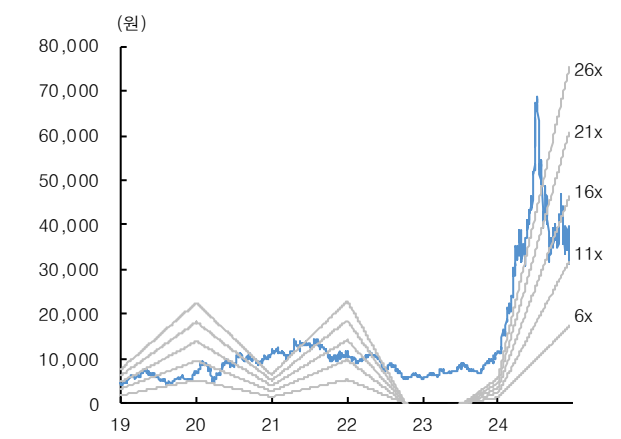
	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24F	2023	2024F	2025F
매출액	29	39	24	41	40	51	47	54	134	192	524
장비	16	22	6	15	19	23	20	25	60	86	386
핸들러	13	18	5	10	17	21	20	23	45	81	107
메모리	10	18	4	8	11	9	14	17	40	51	75
비메모리	2	0	1	1	5	13	6	6	5	30	32
기타장비	4	4	1	5	2	2	0	2	14	6	9
신규장비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
부품	11	14	12	17	21	23	25	26	55	95	116
COK	7	11	8	11	12	13	15	16	37	56	69
기타부품	4	3	4	6	10	9	10	10	17	39	47
자회사	0	3	6	9	6	5	2	3	19	16	22
영업이익	0	2	(3)	3	6	7	6	8	3	27	155
영업이익률	1.4	6.2	(11.1)	7.4	13.8	14.1	13.2	15.6	2.4	14.3	29.5
세전이익	(8)	(1)	(13)	9	(11)	(3)	18	4	(13)	9	138
세전이익률	(28.0)	(2.2)	(53.9)	22.1	(26.4)	(5.5)	38.2	8.1	(9.6)	4.6	26.4
당기순이익	(7)	(1)	(12)	9	(8)	(1)	14	3	(11)	7	109
당기순이익률	(25.2)	(2.4)	(47.6)	21.0	(20.4)	(2.8)	30.2	5.3	(8.3)	3.8	20.9
지배주주순이익	(6)	(0)	(11)	9	(8)	(1)	15	3	(9)	8	109
지배주주순이익률	(21.8)	(1.1)	(46.2)	20.9	(20.5)	(2.2)	31.2	5.9	(7.0)	4.4	20.7

자료: 한국투자증권

밸류에이션

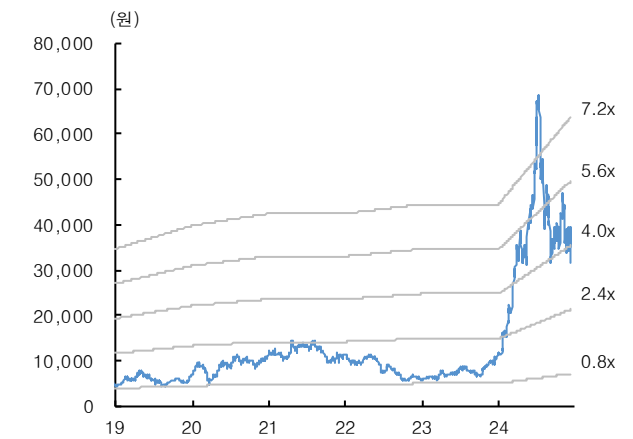
테크윙의 주가는 연초부터 꾸준한 상승을 보이며 급등했지만 신규 장비 관련 추가 이슈 부재 및 반도체 업황 부진으로 상승폭을 일부 반납했다. 하지만 주가하락과 별개로 Cube Prober에 대한 노이즈는 전혀 없는 상태다. 현재 주가는 12개월 선행 PER 기준 10배 수준에 형성되어 있다. HBM 후공정 장비 업체들의 평균 PER은 20배가 넘기 때문에 낮은 수준으로 판단한다. 테크윙에 대해 긍정적인 의견을 제시한다.

[그림 3] 테크윙 12MF PER



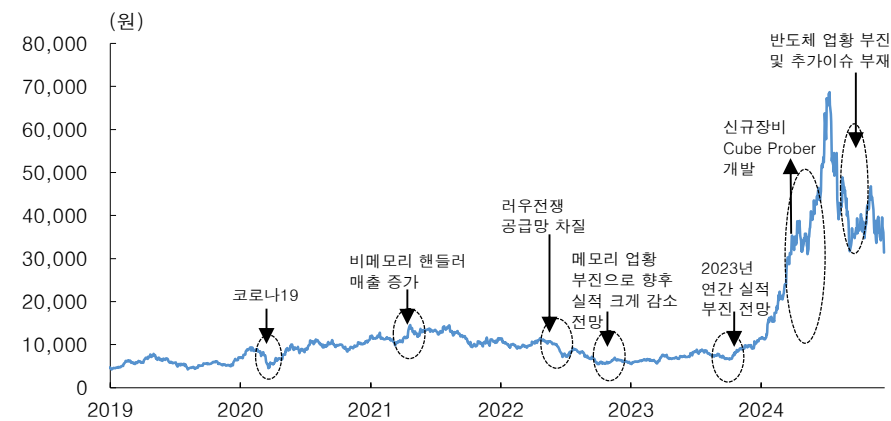
자료: Quantiwis, 한국투자증권

[그림 4] 테크윙 12MF PBR



자료: Quantiwis, 한국투자증권

[그림 5] 테크윙 Historical 주가 흐름 분석



자료: Quantiwis 한국투자증권

<표 2> 국내 및 글로벌 후공정 장비 업체 peer valuation

(단위: 원, 십억원, 달러, 백만달러)

종목		매출액	영업이익	영업이익률	순이익	PER	PBR	EPS	BPS	EV/EBITDA	ROE		
				(%)		(배)	(배)			(배)	(%)		
테크윙	주가 (12/11, 원)	31,900	2022A	267	58	21.6	33	6.4	0.9	886.0	6,582.3	5.5	14.5
	시가총액(십억원)	832	2023A	134	3	2.4	(11)	N/A	1.9	(260.0)	6,188.6	46.9	(4.2)
			2024F	192	27	14.3	7	190.7	6.6	216.9	6,265.3	44.3	3.5
			2025F	524	155	29.5	109	13.6	4.6	3,048.0	9,034.9	10.2	40.1
넥스틴	주가 (12/11, 원)	50,600	2022A	115	57	49.2	43	11.2	4.9	4,433.0	10,100.5	7.4	52.5
	시가총액(십억원)	369	2023A	88	36	41.1	31	22.5	5.6	3,088.0	12,468.7	17.6	27.3
			2024F	88	37	42.6	31	16.4	3.4	3,090.6	14,757.8	11.7	22.1
			2025F	143	59	41.5	54	10.5	2.7	4,831.4	18,942.9	7.8	27.5
한미반도체	주가 (12/11, 원)	83,100	2022A	328	112	34.1	92	12.2	2.9	939.0	4,007.6	8.4	25.0
	시가총액(십억원)	5,606	2023A	159	35	21.7	267	22.4	10.5	2,753.0	5,875.3	134.8	55.5
			2024F	608	268	44.1	212	37.6	11.3	2,209.9	7,383.1	28.6	34.5
			2025F	973	445	45.7	401	20.0	7.4	4,166.3	11,179.6	17.4	45.0
팜트론	주가 (12/11, 원)	5,440	2022A	61	6	10.4	5	10.2	2.3	271.5	1,225.3	8.1	28.0
	시가총액(십억원)	81	2023A	74	8	10.9	7	26.8	5.9	334.5	1,522.5	20.1	24.3
			2024F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2025F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Advantest	주가 (12/11, 달러)	58	2022A	3,713	1,022	27.5	777	21.5	6.2	1.0	3.2	13.6	30.4
	시가총액(백만달러)	44,447	2023A	4,144	1,240	29.9	965	17.4	6.1	1.3	3.8	11.7	39.3
			2024F	3,098	557	18.0	424	98.6	16.1	0.6	3.5	59.7	17.3
			2025F	4,362	1,195	27.4	900	47.3	13.0	1.2	4.5	31.4	28.9
Camtek	주가 (12/11, 달러)	75	2022A	321	81	25.4	80	13.2	2.5	1.8	8.6	8.9	23.6
	시가총액(백만달러)	3,391	2023A	315	65	20.7	79	40.3	6.5	1.8	10.6	39.5	18.3
			2024F	427	129	30.3	138	26.8	5.7	2.8	13.0	23.1	26.8
			2025F	493	155	31.4	159	23.5	4.8	3.2	15.5	19.4	25.0
Onto	주가 (12/11, 달러)	168	2022A	1,005	237	23.5	223	15.6	2.1	4.5	32.8	9.1	14.8
	시가총액(백만달러)	8,278	2023A	816	116	14.2	121	60.8	4.3	2.5	35.4	33.8	7.3
			2024F	984	267	27.1	260	32.0	N/A	5.2	N/A	26.5	14.0
			2025F	1,149	360	31.3	340	25.0	N/A	6.7	N/A	19.1	15.9

주: 테크윙은 한투 추정치, 나머지는 컨센서스 기준. 글로벌 peer의 시가총액은 백만달러 기준
 자료: Bloomberg, 한국투자증권

이슈 정리

1) 본업 2025년 전망

2025년 1분기부터 반등 기대. 고객사의 2025년 언급을 확인해보면 핸들러 업황은 나쁘지 않을 것. 고성능 서버 DDR5, eSSD 등 고부가가치 제품 위주로 투자가 진행될 것으로 전망.

2-1) Cube Prober 쉼 진행 상황

기존 일정으로는 9월 장비 투입, 10월 내 쉼 승인 후 10월 말에 PO를 예상 했었음. 늦어진 이유는 장비 이슈가 아닌 신규 장비에 대한 커스터마이징 등 시간이 길어졌기 때문. 현재 쉼 테스트는 거의 끝난 상황이며 12월 내로 첫 PO가 나올 것. 2025년 1분기에 Cube Prober향 첫 매출이 발생될 것으로 예상.

2-2) 나머지 2개 업체 관련 쉼 진행 상황

나머지 국내 메모리사와의 쉼 일정은 1월 중순으로 확정. 일정이 미뤄진 구체적인 이유로는 장비에 들어가는 프로브카드가 다르고, Cube Prober에 붙는 로더의 커스터마이징이 필요했기 때문. 현재 진행중인 쉼 테스트에서 Cube Prober의 핵심적인 부분은 검증이 되었기 때문에 쉼 테스트 기간은 1달 안으로 끝날 것. 빠르면 2025년 3월 첫 PO 나올 것. 나머지 해외 메모리사와는 2025년 4월~5월 사이 쉼 진입 예상. 관련 PO는 6~7월에 나올 가능성이 높음.

3) Cube Prober 현재 Capa 및 향후 증설 유무

Cube Prober의 경우 매우 정밀한 장비이기 때문에 일반 공정이지만 클린룸에서 생산을 해야 되는 상황. 따라서 기존 엔지니어들이 클린룸에서 작업을 안해봤기 때문에 숙련도를 끌어 올리는데 시간이 필요. 연말까지 30대/월 물량 공급 가능. 2025년 6월 이후로는 월 30대 Capa로는 부족할 것으로 전망되기 때문에 월 생산 대수는 지속적으로 늘릴 것. 추가 증설 관련해서는 성안에 토지 구입을 해놓았으며 건축허가도 받음.

4) Cube Prober 향후 수요 전망? HBM4 관련

고객사들은 2025년 상반기 Cube Prober를 양산에 적용할 준비를 하고 있음. 때문에 회사는 Cube Prober 가이드스를 2025년 연간 120~150대로 제시. 당사는 HBM3E 물량 대응을 고려해 135대를 추정치에 반영했음. 현재 라인당 장비 대수는 4~5대로 추정되며 HBM4로 넘어가면 수요는 더 증가할 것. 2026년에는 300대 정도로 예상되는데 추가 상향 조정 가능성 높음. 적용되는 공정도 늘어나고, 제작 인원들의 숙련도 상승에 따른 물량은 더 많아질 것으로 전망.

5) Cube Prober 경쟁 상황

현재 기준으로 관련 비슷한 장비를 만든 업체로는 국내 1개회사가 있음. 삼성전자 밸류체인 업체인데 아직 요구 성능을 충족하지 못한 것으로 파악되며 개발 및 테스트까지 최소 1년 이상 걸릴 것. 일본 A사의 제품은 양산에 부적합하다는 판정을 받았기 때문에 당분간 독점 구도를 가져갈 것으로 전망.

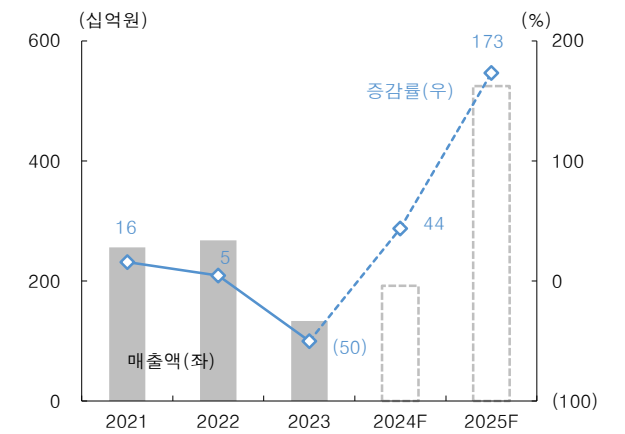
6) 다이레벨테스트 장비 DLP 진행 상황

DLP 장비는 Cube Prober의 원천기술 바탕으로 제작하고 있는 새로운 장비. 정확한 장비 컨셉은 아직 알 수 없으나 비메모리 관련 테스트 장비로 예상. 현재 장비는 발주를 내서 장비를 조립하고 있는 단계이며 2025년 3월 중으로 프로모션을 진행할 예정. 미국의 A사, N사, I사 등이 높은 관심을 보이고 있음. 신규 장비인 만큼 상당한 과급력이 있을 것으로 전망. 현재 당사 추정치에는 DLP 장비는 반영을 안했기 때문에 실적 추정치 추가 상향 조정 가능.

7) 유상증자 가능성

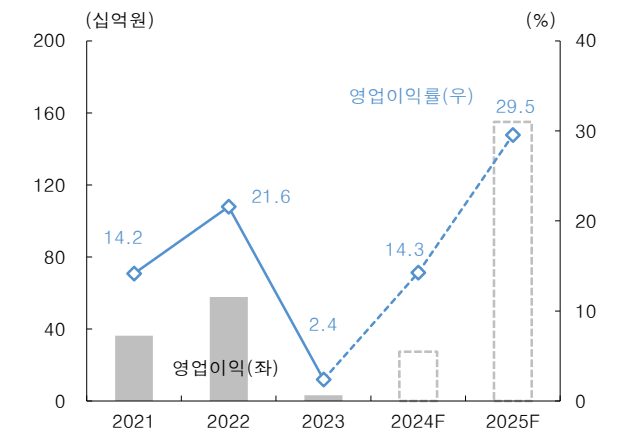
양산 자금이 타이트하기 때문에 유상증자 여부에 대한 시장 우려가 있는 상황. 하지만 유상증자 관련해서 회사는 강하게 부인. 상장 후 유상증자를 했던 이력이 없고 현재 계획도 전혀 없는 상황인 것으로 파악.

[그림 6] 테크윙 연간 매출액 추이 및 전망



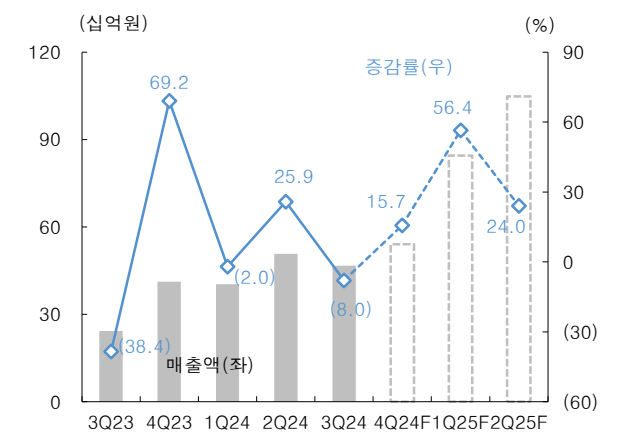
자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 7] 테크윙 연간 영업이익 추이 및 전망



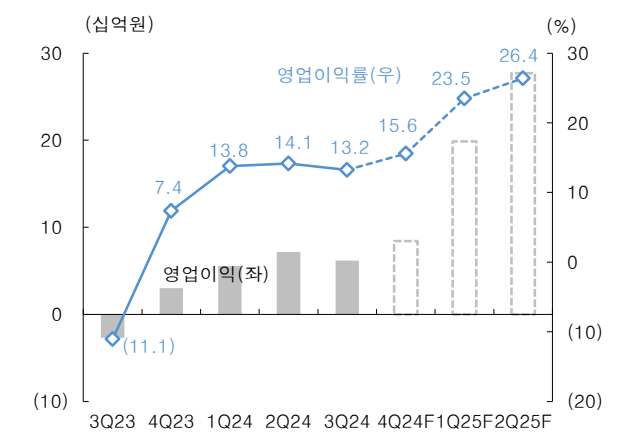
자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 8] 테크윙 분기 매출액 추이 및 전망



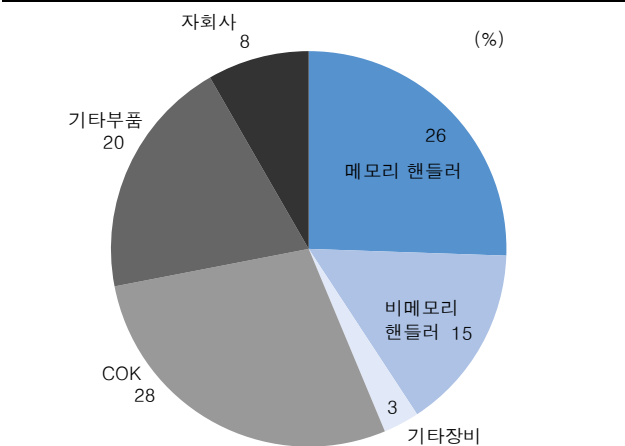
자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 9] 테크윙 분기 영업이익 추이 및 전망



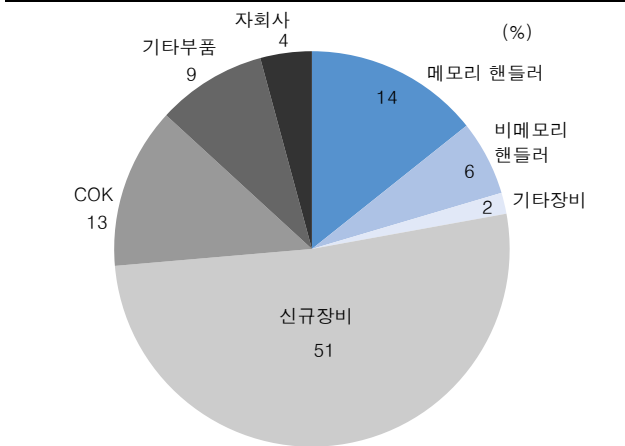
자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 10] 테크윙 2024년 부문별 매출 비중 전망



자료: 테크윙, 한국투자증권

[그림 11] 테크윙 2025년 부문별 매출 비중 전망



자료: 테크윙, 한국투자증권

<표 3> 주요 연혁

연도	내용
2002.07	(주)테크윙 설립
2008.06	세계 최초 128 PARA 테스트 핸들러 개발
2009.06	세계 최초 512PARA 테스트 핸들러 개발
2010.05	모듈 테스트 핸들러 개발
2011.10	세계 최초 768PARA 테스트 핸들러 개발
2011.11	코스닥시장 상장
2013.03	SoC 테스트 핸들러 개발(메모리에서 비메모리로 확장)
2014.06	SSD 테스트 핸들러 개발
2016.02	안성공장 확장 준공
2016.12	1억불 수출탑 수상(한국무역협회)
2022.03	나윤성, 장남 각자대표체제로 전환
2024.05	동탄 본사 확장 준공

자료: 테크윙, 한국투자증권

기업개요 및 용어해설

테크윙은 반도체 후공정 장비 회사로 2002년 설립 후 2011년 코스닥에 상장. 주력 제품은 테스트 공정에서 사용되는 메모리 테스트 핸들러이며 현재 비메모리 핸들러, SSD/모듈 핸들러, Probe Station 등 다양한 제품군을 보유. 2023년 기준 메모리 핸들러는 30%, 비메모리 핸들러는 4%, 기타장비 10%, COK는 28% 등을 기록

- 테스트 핸들러(Test Handler): 반도체 후공정 중 테스트 공정에서 사용되는 테스트를 보조하는 자동화 장비

손익계산서

(단위: 십억원)

	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	187	228	256	267	134
매출원가	123	145	169	158	84
매출총이익	64	83	87	109	50
판매관리비	40	46	51	52	46
영업이익	24.4	37.9	36.2	57.6	3.2
영업이익률(%)	13.1	16.6	14.2	21.6	2.4
EBITDA	32	47	47	69	13
EBITDA Margin(%)	17.3	20.6	18.2	25.8	10.1
영업외수익	(11)	3	(14)	(15)	(16)
금융수익	2	4	3	3	4
금융비용	7	6	7	12	7
기타영업외손익	(7)	5	(10)	(6)	(13)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	13	41	22	43	(13)
법인세비용	1	8	5	9	(2)
연결당기순이익	11	33	17	33	(11)
지배주주지분순이익	11	32	18	33	(9)
지배주주순이익률(%)	5.8	14.1	7.0	12.2	(7.0)
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	(3.5)	22.1	12.2	4.5	(50.1)
영업이익 증가율	(2.8)	55.4	(4.5)	59.2	(94.5)
지배주주순이익 증가율	(45.9)	195.3	(43.9)	81.4	NM
EPS 증가율	(46.5)	193.2	(71.8)	266.9	NM
EBITDA 증가율	1.1	45.2	(0.8)	47.6	(80.5)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
영업활동현금흐름	21	25	2	82	20
당기순이익	11	33	17	33	(11)
유형자산감가상각비	6	6	7	8	7
무형자산상각비	2	3	3	4	3
자산부채변동	(8)	(19)	(44)	9	10
기타	10	2	19	28	11
투자활동현금흐름	(8)	(25)	(65)	(39)	(67)
유형자산투자	(3)	(20)	(55)	(10)	(44)
유형자산매각	1	0	0	1	0
투자자산순증	5	(2)	(5)	(26)	(10)
무형자산순증	(3)	(3)	(5)	(4)	(9)
기타	(8)	0	0	0	(4)
재무활동현금흐름	(8)	15	53	(40)	37
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(4)	19	57	(23)	42
배당금지급	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)
기타	0	0	0	(13)	0
기타현금흐름	(0)	(0)	0	(0)	(0)
현금의증가	4	14	(9)	3	(10)
FCF	0	0	0	0	0

주: K-IFRS (연결) 기준

재무상태표

(단위: 십억원)

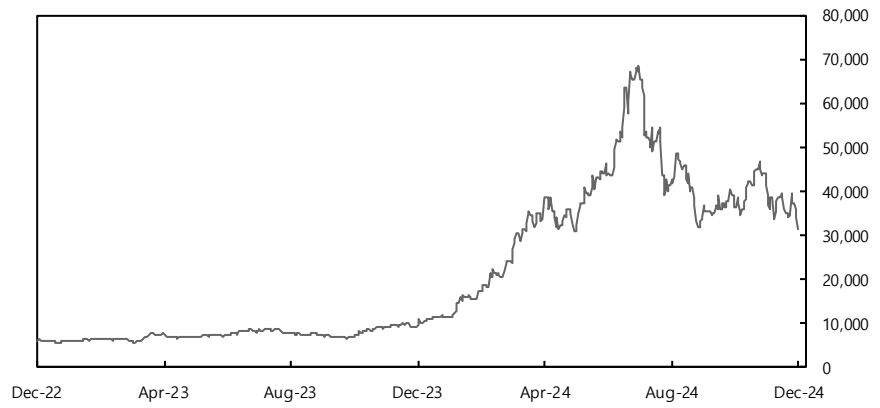
	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
자산총계	379	416	509	488	486
유동자산	169	192	229	181	144
현금성자산	15	30	20	23	14
매출채권및기타채권	67	66	90	54	40
재고자산	61	65	85	87	81
비유동자산	210	224	279	307	342
투자자산	2	3	3	31	27
유형자산	186	201	242	243	271
무형자산	18	18	20	18	21
부채총계	191	200	278	243	270
유동부채	120	139	147	177	139
매입채무및기타채무	33	29	35	18	21
단기차입금및단기사채	60	65	83	57	74
유동성장기부채	12	36	8	84	38
비유동부채	71	61	131	66	131
사채	34	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	31	55	125	56	120
자본총계	189	216	230	246	216
지배주주지분	175	202	217	232	217
자본금	10	10	10	19	19
자본잉여금	48	48	50	41	41
기타자본	(9)	(9)	(9)	(14)	(14)
이익잉여금	127	153	167	187	172
비지배주주지분	13	14	13	14	(1)
순차입금	108	99	173	167	215

주요 투자지표

	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
주당지표(원)					
EPS	292	856	242	886	(260)
BPS	4,822	5,532	5,898	6,582	6,189
DPS	116	116	116	130	130
수익성(%)					
ROA	3.2	8.3	3.7	6.7	(2.3)
ROE	6.4	17.0	8.6	14.5	(4.2)
배당수익률	1.7	1.0	1.0	2.3	1.1
배당성향	39.7	13.4	24.0	14.2	NM
안정성					
부채비율(x)	101.2	92.3	120.8	98.8	125.4
차입금/자본총계비율(%)	78.1	72.8	97.3	83.8	109.2
이자보상배율(x)	5.1	11.0	12.0	14.3	0.6
순차입금/EBITDA(x)	3.4	2.1	3.7	2.4	16.5
Valuation(x)					
PER	24.1	14.0	47.4	6.4	NM
최고	27.9	14.2	61.6	13.2	NM
최저	14.0	5.0	38.2	5.9	NM
PBR	1.5	2.2	1.9	0.9	1.9
최고	1.7	2.2	2.5	1.8	1.9
최저	0.9	0.8	1.6	0.8	0.9
PSR	1.4	2.0	1.7	0.8	3.2
EV/EBITDA	11.8	11.9	13.2	5.5	46.7

투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가대비
테크윙 (089030)	2022.08.17	NR	-	-	-
	2023.08.17	1년경과	-	-	-
	2024.08.17	1년경과	-	-	-



■ Compliance notice

- 당사는 2024년 12월 12일 현재 테크윙 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 기업 투자 의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 추가 등락 기준임

- 매 수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 추가 상승 예상
- 중 립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 추가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 추가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2024. 9. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
84.4%	15.6%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자 의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높게 가져갈 것을 권함
- 중 립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.